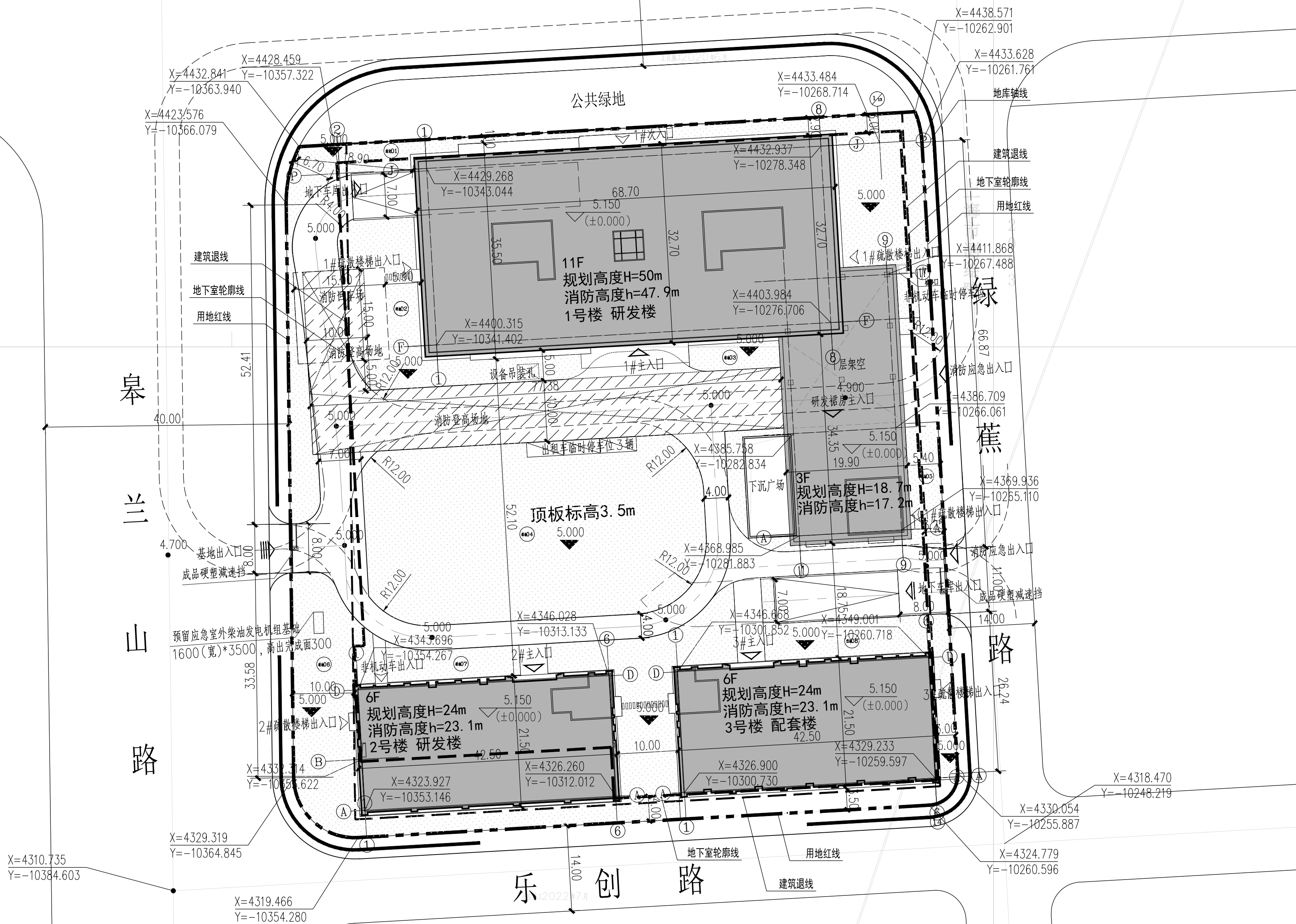
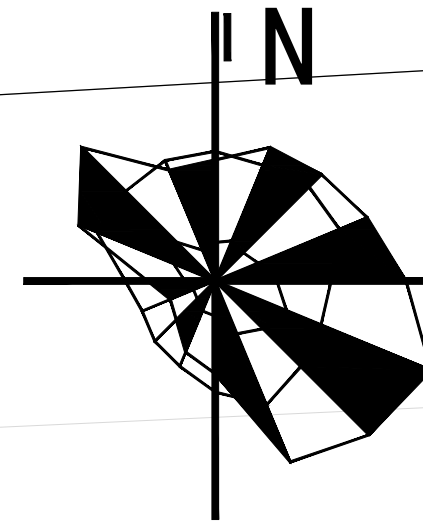


总平面图图例：

	用地红线		禁止机动车开口段
	地下室范围线		道路绝对标高
	建筑轮廓线		道路坡度、坡长
	建筑首层轮廓线		绿地
	正负零绝对标高		绿化(不计入绿地率)
	室外绝对标高		绿地编号
	建筑高度(规划)		基地出入口
	建筑高度(消防)		机动车库出入口
	测量坐标		建筑主入口
	机动车道、道路中心线		建筑次入口、非机动车出入口
	消防车道		



总平面图 1:500



说明：

- 本工程是根据建设单位提供的用地红线及坐标、地形图和建设用地周边市政道路的标高，建设单位与有关部门协商确定的共用道路进行设计的。
- 图中坐标与用地红线坐标系一致，为上海市坐标系。
- 图中建筑物平面为建筑物的外墙轮廓平面。
- 图中标注的尺寸均为建筑物幕墙完成面之间、建筑物幕墙完成面与相邻构筑物之间，或建筑物退用地红线的距离。
- 建筑物的定位坐标为轴线交点坐标。
- 图中路面宽4.00米及以下道路均为单面坡，其余均为双面坡，横坡均为1.5%，广场坡度为1.0-3.0%。
- 广场、绿地、花池、围墙等，另详景观设计。
- 图中尺寸、坐标和标高均以米为单位。
- 本工程设计标高±0.000相当于吴淞高程5.150m。
- 本图中单体高度，H为室外地面至女儿墙顶端高度h为室外地面至大屋面高度。
- 用地四至及各单体建筑的定位坐标必须在现场用地上放线复核，经复核确认现场用地四至情况及各单体建筑定位关系在实地放线中与设计图纸、规划或测绘地界坐标复核无误后再进行施工。
- 借用市政道路皋兰山路、武山路、绿藻路为消防道路。

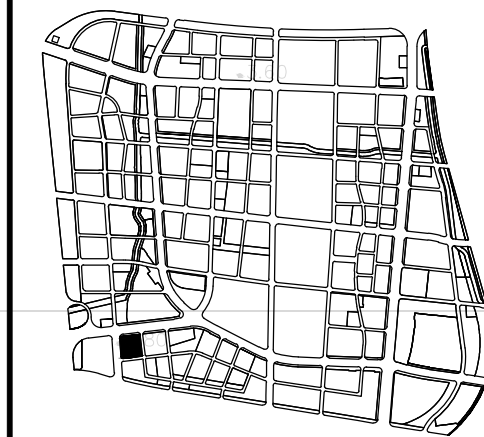
104-02主要经济技术指标				
序号	名称	数据	单位	备注
1	总用地面积	12,110.33	m ²	
2	总建筑面积	4,293.55	m ²	
3	建筑密度	35.45	%	
4	总建筑面积	56,645.96	m ²	
其中	地上建筑面积	37,285.90	m ²	
	地下建筑面积	19,360.06	m ²	
5	生活配套	5,449.65	m ²	15.00%
6	产业配套	261.57	m ²	1%，产业配套仅在1号楼的3、5、7层
7	计容建筑面积	36,330.99	m ²	
其中	不计容建筑面积	954.91	m ²	
	1号楼裙房架空层	403.91	m ²	
	其他	551.00	m ²	1#楼4F裙房出屋面楼梯+机房面积为105.97m ² ；1#屋顶设备层楼梯间+机房面积为279.77m ² ；2#出屋面楼梯间+电梯机房面积为82.63m ² ；3#出屋面楼梯间+电梯机房面积为82.63m ²
9	容积率	3.00		
10	绿地面积	4,238.62	m ²	
11	绿地率	35.00	%	
12	光伏面积	1,463.93	m ²	屋顶投影面积30%
13	机动车停车位	329	辆	
其中	地上停车位	—	辆	出租车停车位3辆
	地下停车位	329	辆	
	其中	普通车位	261	辆
		无障碍车位	4	辆
		充电车位	64	辆

中国建筑设计研究院有限公司
CHINA SHANGHAI ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.合作设计单位：
JOINTLY DESIGNED WITH

合作设计单位

会签：
SIGNED:院出图章：
PROJECT SEAL

本图未加盖院出图章无效

注册执业章：
REGISTERED SEAL备注：
NOTE

1.1 根据规划意见修改 2024.05

1 送审 2024.04

版本 升版原因 升版日期

REVISION CAUSE DATE

本图升版后，以最高版本为准

发件人：

CLIENT

上海灿瑞微电子有限公司

工程名称：

PROJECT NAME

灿瑞科技全球芯片研发中心项目
总图

图名：

DRAWING TITLE

总平面图

合同编号：

PROJECT No.

SH230505

设计总负责人

PROJECT DIRECTOR

孟凡理

审定人

AUTHORIZED BY

郭松林

审核人

PROCESSED BY

郭松林

专业负责人

DISCIPLINE RESPONSIBLE BY

孟凡理

校对

CHECKED BY

程未科

设计人

DESIGNED BY

徐 鹏

专业：

DISCIPLINE

建筑

图号：

DRAWING No.

ZT001

阶段：

STATUS

施工图

比例：

SCALE

1:500

日期：

DATE

2024.05

文件名：

FILE NAME